

Inicjatywa spotkania przedstawicieli polskich ośrodków badawczych zajmujących się pomiarem naprężeń w materiałach z wykorzystaniem technik dyfrakcji rentgenowskiej powstała wiosną 2012r w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Celem takiego spotkania była potrzeba skonsolidowania środowiska badaczy zajmujących się identyfikacją tej użytecznej charakterystyki materiałów, jaką jest stan odkształcenia sprężystego ich mikrostruktury – naprężeń własnych. Zarówno poziom, jak i konfiguracja utrzymujących się naprężeń własnych w znacznym stopniu warunkują właściwości eksploatacyjne elementów konstrukcyjnych. Stąd też, poznanie ww. charakterystyki jest bardzo istotne przy projektowaniu materiałów czy ocenie czasu bezpiecznej eksploatacji określonych konstrukcji. Ponieważ techniki doświadczalne, jak i rozwiązania metodologiczne z zakresu identyfikacji naprężeń są wciąż udoskonalane, wymiana informacji oraz potrzeba weryfikacji własnych osiągnięć stały się naturalną potrzebą badaczy w przedmiotowym zakresie. Na pierwszym zebraniu w Instytucie Lotnictwa postanowiono kontynuować inicjatywę tego typu spotkań służących:

-  
wymianie dobrych praktyk pomiarowych,

-  
wymianie informacji na temat metodologii pomiarowej,

-  
prezentacji zagadnień podejmowanych przez poszczególne zespoły naukowe,

-  
prezentacji wyników badań i ich aplikacji w praktyce.

Tak narodziła się idea *Sympozjum Pomiaru i Interpretacji Naprężeń SPINA*.

Kolejne spotkania, które odbyły się w Warszawie (Instytut Lotnictwa, maj 2012), Skawinie (OML/IMN, grudzień 2012), Częstochowie (Politechnika Częstochowska, listopad 2013),

Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska, listopad 2014), Łodzi (Politechnika Łódzka, czerwiec 2015) utwierdziły ich uczestników w potrzebie kontynuowania SPINA.

W roku 2016 planowana jest kolejna SPINA, tym razem w Krakowie (IMIM PAN). Dokładne informacje będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej [www.imim.pl](http://www.imim.pl)

Prof. dr hab. inż. Jan Bonarski

IMIM PAN, Kraków

### **Miejsce**

Więcej informacji wkrótce.

### **Program**

Więcej informacji wkrótce.

### **Rejestracja**

Więcej informacji wkrótce.

### **Informacje dodatkowe**

Więcej informacji wkrótce.